

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 887,588,324 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况



1、公司简介

股票简称	麦捷科技	股票代码	300319
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	居济民	王大伟	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园	
传真	无	无	
电话	0755-82928319	0755-82928319	
电子信箱	securities@szmicrogate.com	securities@szmicrogate.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司核心业务与产品体系

公司专注于高端电子元器件及模组的研发、生产和销售，核心业务覆盖磁性元器件、射频器件、显示模组三大板块，产品广泛应用于通讯设备、消费终端、新能源、汽车电子、服务器、工业控制、安防设备等领域。报告期内，公司通过垂直整合产业链及拓展全球化市场等关键举措，不断夯实自身在行业的领先地位。

产品分类	代表产品	产品特点	主要应用	产品图示
磁性元器件	一体成型电感	高磁屏蔽性能、低电阻、低损耗	手机、消费电子、车载中控、汽车车灯	
	共模电感	体系小、适合高密度自动贴装、抑制噪声好	电视、笔电、汽车 CAN	
	叠层片式电感	独石结构可靠性好、偏差小、精度高	手机、通讯模块、电视、安防	

	<p>PFC 电感</p>	<p>空间利用率高、大电流、抗高饱和和电流</p>	<p>通讯设备、汽车电子</p>	
	<p>TLVR 电感</p>	<p>大电流、低 DCR 值、组合式/一体成型</p>	<p>CPU/GPU 多相电源、电源模块、智能驾驶、通讯基站</p>	
	<p>电感变压器</p>	<p>高性能、低电阻、散热性好</p>	<p>车载</p>	
	<p>集成变压器</p>	<p>高性能、低电阻、高饱和和电流</p>	<p>车载 OBC</p>	

	铁硅、铁硅铝系列	高叠加、低损耗	汽车电子、光伏逆变器、充电桩、白色家电	
射频器件	LTCC 射频器件	低插损、高抑制、独石结构可靠性好、体积小	手机、电视、平板笔电、汽车电子	
	射频模组	高增益、低噪声、高线性度、带外高抑制、低插损、谐波小	手机、平板笔电	
	声表面波双工器	CSP 工艺一致性好	手机	
显示模组	LCD LCM	高对比、高亮度、高色域	平板笔电	

1、磁性元器件

公司磁性元器件业务主要涵盖功率绕线电感、一体成型电感、叠层电感、平板变压器及金属软磁材料等核心产品，是公司营收的重要支柱，其中一体成型电感产销量位居大陆龙头，精密绕线电感和高频定制磁性器件亦稳居行业前列。

(1) 功率绕线与 TLVR 电感——AI 算力与新能源双轮驱动的主力产品

功率绕线电感是电子设备电源管理系统的核心元件，负责电能的储存与转换。公司的功率绕线电感采用精细化绕线工艺与高磁导率磁芯材料，在小尺寸封装下实现高电流承载能力与低直流电阻特性，适配 5G 基站、服务器电源、汽车电子等大功率场景。根据 QY Research 报告数据显示，2025 年全球功率电感市场规模突破 50 亿美元，公司凭借车规级认证与高可靠性优势，在新能源汽车领域的渗透率持续提升，产品已通过 AEC-Q200 认证，满足 800V 高压平台的严苛要求。公司的微型功率绕线电感还广泛应用于智能手表、无线耳机等穿戴设备，通过扁平铜线技术优化，实现损耗与功率密度性能的双重突破，契合消费电子小型化、高效化的发展趋势。



(2) 一体成型电感与一体成型 TLVR——AI 算力爆发的核心受益产品

一体成型电感是公司的战略核心产品，也是 AI 服务器电源模块的关键元器件。公司产品采用的非晶纳米晶软磁合金材料，在高频损耗与效率方面较传统铁氧体材料表现优异，是国内少有的在高频特性和饱和特性上满足下游严苛要求的优质供应商。该产品目前已进入全球顶级 AI 芯片与服务器供应链，随着 AI 算力需求持续增长，相关市场预计保持 10% 以上的年复合增长。公司还针对 AR/AI 眼镜及旗舰手机推出专用型号，如 MPSM141208BVR 和 MPSM141206BVR，分别适配中高端移动平台和功耗敏感型旗舰设备，形成全场景产品矩阵。此外，公司 TLVR (MTVM 系列) 一体成型电感在 GPU 算力芯片的 Multi-phase 垂直供电系统具有不可替代的关键作用，其不仅承担 DC-DC 作用，同时还起到信号传递与散热的功能，是算力系统不可或缺的电力电子元器件，公司在材料、产品设计与工艺平台的创新都是实现高功率密度 TLVR 产品的核心基础。



(3) 叠层电感——高频通信场景的优选方案

叠层电感采用多层印刷工艺，具有小型化、高可靠性等优势，适配 5G 中高频、WiFi 7 及毫米波预备频段的应用需求。公司叠层电感通过陶瓷材料配方优化与工艺改进，实现工作频率覆盖 1MHz-40GHz，在 LTCC 集成模块中应用广泛。根据 QY Research 报告数据显示，相关市场预计保持 7% 以上的年复合增长，公司凭借在中低频段的技术积累，逐步向高频段渗透，产品在 5G 基站射频单元等场景实现批量供货。公司的高 Q 值叠层电感未来有望逐步应用于低空经济相关领域，通过材料与工艺设计满足产品在飞行环境下的稳定运行要求。



(4) 平板变压器——高频化与超薄化引领行业变革

平板变压器作为传统绕线变压器的升级产品，采用 PCB 铜箔替代传统漆包线，具有体积小、效率高、散热好等显著优势。公司的平板变压器采用新型导热材料与磁集成技术，薄至 8-12mm，体积仅为传统产品的 20%-30%，高频损耗与散热效率指标均位居国内前列，有效解决大功率场景的散热难题，成为高端电源模块的首选方案。

(5) 金属软磁材料——核心技术自主可控的护城河

金属软磁材料是磁性器件的核心基础材料，公司通过收购安可远和参股中科宏晶有效实现了金属软磁粉芯与非晶纳米晶材料等核心材料的稳定供应。目前公司已掌握 Fe-Ni（铁镍）、Fe-Si（铁硅）、Fe-Si-Al（铁硅铝）等粉体成分设计，拥有多项专利，通过表面包覆技术降低涡流损耗，高压压铸+高温固

化工艺避免高频涡流损耗。公司磁粉芯技术经过持续迭代，其高频特性已完全适配 AI 算力服务器和新能源汽车 800V 及更高车型架构，在 AI、车载电源、OBC 等领域的应用快速增长。

2、射频滤波器与 MEMS 传感器

公司是国内少有的可同时量产 SAW 与 LTCC 工艺射频前端器件的厂商，产品覆盖从低频到毫米波的全频段应用，满足客户多样化场景需求。根据 Yole Group 报告显示，2025 年全球射频滤波器市场规模约 90 亿美元，国内厂商在中低频段的技术与市场份额快速提升，公司凭借本土化服务与性价比优势，成为国产替代的核心参与者。

（1）SAW 滤波器与 MEMS 传感器：中低频段的主流解决方案

SAW 滤波器是手机、物联网设备等消费终端的核心射频元件，负责信号的滤波与选频。近年来，公司的 SAW 滤波器朝着温度补偿、高频化方向升级，通过新型压电材料与电极设计，实现温度稳定性提升，适配 5G 中高频及毫米波预备频段；公司在中低频段（600MHz-3GHz）的技术已高度成熟，现已成为国内主流手机厂商的核心供应商；公司的车规级 SAW 滤波器也在逐步适配车载无线通信场景，通过 AEC-Q100 认证，可满足车载环境的宽温、抗振动等严苛要求。同时，公司充分发挥自身在中低频段积累的成熟技术与工艺优势，深化跨领域技术协同，围绕射频生产设备与制造工艺平台，推进 MEMS 光通信器件及智能传感器产品在核心技术、制程工艺、生产装备上的深度复用，通过技术同源、工艺共享、设备共用实现研发与量产效率双提升，以新技术、新产品赋能射频业务结构优化升级。随着具身智能市场的蓬勃发展，公司的 MEMS 传感器产品也将大放异彩。

（2）LTCC 射频器件：毫米波时代的集成化方案

LTCC 射频器件是 5G 基站、毫米波通信设备的关键元件，具有高频率、高 Q 值、高集成度等优势。公司的 LTCC 射频器件工作频段向毫米波延伸，单模块可整合滤波器、巴伦器、双工器等多类无源元件，在 5G 基站中的应用渗透率持续提升；公司通过陶瓷材料配方优化与多层布线工艺改进，降低信号传输损耗，提升器件可靠性，产品稳定供应国内头部通信设备厂商供应链；在低空经济领域，LTCC 微波器件因耐高温、抗辐射等特性，成为无人机、eVTOL 乃至卫星通信系统的优选方案，公司现已实现相关产品的技术突破，为后续拓展高端市场奠定基础。

3、显示模组

公司显示模组业务涵盖 LCM 与背光两大板块，产品主要应用于平板笔电、电竞显示器、工业控制、车载显示、智能家居等领域。根据 Global Info Research 数据显示，全球显示模组市场规模已突破千亿美元，窄边框、高刷新率逐步成为技术升级的主流方向。公司主要聚焦全球高端客户进行产品研发与交付。



(二) 报告期内业务变化

1、产品结构优化：AI 电感、车规级产品营收较上年增长近六成，是公司业绩增长的核心驱动力；通讯及消费电子领域产品营收占比保持稳定，仍是公司高毛利业务的核心根基。

2、产能布局扩张：报告期内公司智慧园二期、智慧园三期、越南鑫智泰公司同步建设实现产能扩张，目前智慧园二期已投入使用，智慧园三期主体已封顶，预计 2026 年全部竣工后投入使用，越南鑫智泰公司也已完成首条产线铺设，现已向客户提供生产样品，待各项目完全达产后，预计每年可增加整体产值超 10 亿元，有效缓解公司产能紧张的局面，支撑新兴业务快速发展。

3、技术研发突破：报告期内公司将 AI 辅助广泛投入于研发工作，通过引入 AI 算法优化产品设计流程，在缩短研发周期的同时提升产品性能，在磁性器件的磁路设计、射频器件的频率优化等方面取得显著成效；同时，公司在材料研发领域积极推进与国内顶尖高校的合作，共同开发用于材料配方研究的 AI 算法模型，并建立离散仿真材料模型，在前述模型大幅提升研发效率、缩短研发周期的基础上，公司已全面展开宇航级粉料及绝缘包覆技术的研发工作，为公司在低空经济与商业航天领域奠定关键材料基础，助力宇航级产品的研发与交付。

4、客户质量提升：公司在通讯、消费电子等传统领域未完全恢复的情况下，逆势提升了核心客户的销售份额，成为国内外消费电子、AI、车载产业链中头部企业的重要供应商，报告期公司海外收入占比提升至 37%，客户全球化布局成效显著。

5、体系工艺升级：在车规级认证成为高端电子器件标配的当下，公司的磁性器件、射频器件及显示模组产品相继通过 AEC-Q 系列认证，在车载领域的应用渗透持续加深；同时公司通过工艺改进与设备升级，大幅降低单位产值能耗，在金属软磁材料的生产过程减少有害物质使用，使产品符合欧盟 RoHS 等环保标准。

（三）公司经营模式

1、研发模式

公司坚持“市场导向、自主研发、产学研合作”的研发理念，建立了以技术中心为核心，涵盖材料研发、产品设计、工艺优化、测试验证等环节的全链条研发体系。技术中心下设磁性材料研究所、射频技术研究所、显示模组研究所等多个专业研发部门，拥有研发人员 599 人，占员工总数的 14.76%，核心研发人员均具备 10 年以上行业经验。

报告期内，公司研发投入总额达 1.70 亿元，占营业收入的 4.49%，研发投入强度高于行业平均水平。研发项目聚焦 AI 服务器电感、电源模块、车规级高频器件等重点领域，其中“AI 服务器大电流电感研发及产业化”项目获国家工信部“新一代信息技术产业创新项目”立项支持，“车规级毫米波射频模组研发”项目入选省级科技重大专项。

产学研合作方面，公司与西安交通大学、电子科技大学、中南大学、华南理工大学等高校科研机构建立长期合作关系，共建“电子元器件联合实验室”，开展磁性材料、射频技术等前沿领域的研究，有效提升了公司的技术研发实力与创新效率。

2、采购模式

2025 年，公司延续并优化直接采购模式，结合生产计划、原材料市场行情及库存管控需求统筹制定采购策略，持续完善分级供应商管理体系，强化采购全流程品质把控，保障原材料供应稳定、采购流程规范高效。依托产业链整合布局，公司进一步深化控股子公司间的供应协同，优化核心原材料供应体系，提升产业链自主配套能力；同时加强与金之川、安可远之间的采购协同，整合供应商资源，统一采购标准与质量管控要求，有效提升整体供应链运营效率。

为适配业务全球化布局与汽车电子等高端业务发展需求，公司持续推进采购管理数字化升级，实现采购全流程线上化运作与数据互联互通，提升供应链响应速度。伴随海外生产基地建设推进，公司拟逐步搭建全球化供应网络，构建多元化供应格局，增强供应链韧性。针对车规级产品业务，公司建立符合行业规范的专项采购管理体系，严格供应商准入与认证管理，推行多源供应保障机制，满足下游客户严苛的品质及交付标准。公司通过供应商动态评估与战略合作深化，持续优化供应生态，为核心业务稳健发展提供可靠的供应链支撑。

3、生产模式

公司采用“以销定产、适度备货”的生产模式，结合客户订单需求与市场预测制定生产计划，实现产能的高效利用。生产管理方面，公司推行精益生产管理体系，通过 ERP、MES 等信息化系统实现生产过程的全流程管控，从原材料采购、生产加工、质量检测到成品出库，每个环节均建立严格的质量控制标准，确保产品质量符合客户要求。

供应链管理方面，公司建立了完善的供应商认证与管理体系，对原材料供应商进行严格的资质审核、样品测试与现场审核，核心原材料供应商均为行业头部企业，确保原材料的质量稳定性与供应安全性。公司还通过与供应商签订长期供货协议、建立战略库存等方式，有效应对原材料价格波动风险。

生产基地布局方面，公司在深圳、成都、惠州、越南海防四地布有生产基地，分别开展磁性与射频器件、变压器与金属软磁材料产品的制造工作，形成“分工明确、协同互补”的生产格局。目前三大基地均有通过 ISO9001、IATF16949 等国际质量体系认证，具备行业前列的规模化、智能化生产能力。

4、销售模式

公司销售模式以直销为主、经销为辅，其中直销收入占比达 84.22%。直销模式主要针对国内外大型企业客户，通过设立专门的销售团队负责客户对接、需求沟通、订单洽谈与售后服务，建立长期稳定的合作关系；经销模式主要针对中小客户与部分新兴市场，通过选择具备良好市场资源与渠道优势的经销商，拓展市场覆盖面，提高产品市场渗透率。

海外市场拓展方面，公司在美国硅谷、德国慕尼黑、韩国龙仁设有海外销售网点，配备专业的销售与技术支持团队，主要负责北美、欧洲等海外客户的开发与维护，其中北美市场收入增幅显著，是公司海外业务的核心增长点。

客户服务方面，公司建立了“售前咨询-售中支持-售后服务”的全生命周期客户服务体系，售前为客户提供产品选型、技术方案设计等专业咨询服务，售中协助客户进行产品测试与验证，售后及时响应客户的技术支持与产品维修需求，客户满意度长期保持在 99%以上，良好的客户服务也为公司赢得了广泛的市场口碑与客户忠诚度。

（四）公司市场地位与竞争优势

1、产品市场地位

公司作为国内领先的磁性元器件及射频器件供应商，核心产品一体成型电感产销量位列大陆头部，精密绕线电感和高频定制磁性器件亦稳居前列，2025 年顺利收购惠州安可远后现已具备材料、工艺及开发平台的完整技术能力；此外，公司是国内少有的可同时量产 SAW 与 LTCC 不同工艺射频前端器件的厂商，满足客户不同应用场景的广泛需求。公司坚守主业二十余载，始终秉持“人才为本、技术为先”的经营理念，不断丰富高素质人才梯队，持续向技术创新、研发制造等重点领域投入大量资源，同时积极兼并吸收行业内优质企业，有机整合各条产品线的技术资源和供应链资源，努力践行尖端的、与时俱进的智能与智慧型产品研发模式，致力为全球无线通讯系统、云计算及物联网接入提供最先进的电子元器件产品。公司凭借着持续的研发创新与产业优化，正逐步从“国产替代”供应商跃升为全球磁性与射频产业的头部参与者。

2、公司竞争优势

(1) 产业链优势：公司坚持自主研发，建立了完整先进的算法设计与工艺仿真平台。2024 年完成对安可远的股权收购后，公司打通磁性产业链上游，实现从材料到器件的全产业链能力，大幅提升生产效率并有效降低整体成本。例如通过研发改进气雾化喷嘴技术，提升可用粉收得率，降低雾化制粉成本，实现高性能铁硅、铁硅铝磁粉的产业化；通过一体化成型技术，将分离式组合磁芯做成一体式成型组合磁芯，显著提升下游厂商生产效率与产品品质。

(2) 客户资源优势：经过多年积累，公司拥有 OPPO、VIVO、中兴、荣耀、小米、三星、传音、华勤、闻泰、龙旗、天珑、TCL、联想、冠捷、海信、Amazon、Google、Facebook、META、MOTO、比亚迪、零跑、麦格米特、汇川、英搏尔、威迈斯、阳光等众多国内外一线客户；在 AI 与服务器领域中，公司已与摩尔线程、天数智芯、浪潮、H3C、海光、超聚变、NVIDIA 等客户建立了良好的技术与产品合作，在高通多个平台送测的产品效率位居全球前列；在汽车电子领域，公司与安波福、法雷奥、博世、大陆等国际 Tier1 厂商达成合作，多款料号通过认证并实现批量供应。

(3) 产品力优势：公司持续推进高端产品结构优化，以一体成型电感、共模电感为代表的高端产品在市场端份额持续提升。公司芯片电感用耐高温低损耗金属软磁粉料研发及产业化项目成果将赋能铜铁共烧电感量产，使产品满足国际头部算力厂商 AI 芯片的供电需求，助力其突破“功耗墙”。公司实现从粉料配方、绝缘包覆到共烧工艺的全链条国产化，打破日系厂商技术垄断，保障我国在 AI、超算等关键领域的供应链安全，支撑国家新材料产业规划中“先进磁性材料”专项落地。

(五) 主要业绩驱动因素

2025 年公司业绩增长主要得益于：与“十四五”初期确立的“深化消费电子领域合作、谋划汽车电子领域国际化布局、突破算力服务器领域关键客户、增强射频器件自主供应能力与协助显示模组业务转型”业务规划核心高度一致。

1、AI 算力基础设施建设需求爆发：随着 AI 大模型技术快速发展，全球服务器市场规模预计到 2028 年将达到 2,730 亿美元，专为 AI 应用设计的服务器更是将占到市场总额的半数以上

(TechInsights 2024 服务器预测数据)。公司 AI 服务器专用电感产品能量转换效率适配高压架构与高频场景，满足高频、高电流、高效率、小体积等多个核心应用要求，2025 年 AI 业务已然成为公司业绩增长的核心引擎。

2、新能源汽车与车规级市场快速拓展：2025 年我国新能源汽车销量持续增长，带动车规级电子元器件需求大幅提升。汽车电子领域单车电子元件价值量约达到传统车的 3 倍，公司在车载 OBC、DC/DC 转换器用变压器及功率电感产品方面优势明显，众多料号通过 AEC-Q200 车规认证，与众多国内龙头企业及国际 Tier 1 厂商的合作不断深化，车规业务逐步进入收获期。

3、5G 通信与基站建设持续推进：尽管 5G 建设已进入中后期，但全球 5G 基站数量仍保持稳定增长，公司通讯基站用功率电感与国内龙头通讯厂商深度绑定，持续受益于 5G 网络优化与扩容带来的需求增长；同时，5G-A 技术的逐步商用推动射频器件需求升级，公司的高端滤波器产品有望实现更大规模应用。

报告期内，公司业绩表现呈现出明显的结构性特征，高端市场增长迅速而传统市场恢复较慢，这与电子元器件行业向 AI、新能源汽车等新兴领域转型的整体趋势高度一致。公司通过提前布局 AI 服务器、车规级产品等高端赛道，有效把握了行业发展机遇，同时通过全产业链整合与技术创新应对行业挑战，为未来持续发展奠定了坚实基础。

（六）业绩变化与行业发展契合度

2025 年，公司实现营业收入 37.94 亿元，同比增长 20.44%，业绩增长态势与行业发展趋势较为契合。从行业层面看，磁性器件、射频器件、显示模组行业在报告期内均处于正向增长阶段，受益于新兴领域需求爆发与国产替代加速，电子元器件行业整体增长率维持在 7.2-8.5% 之间（Gartner 2025 半导体报告数据）；从公司层面看，公司业绩增长率高于行业平均水平，主要得益于公司在高端产品领域的技术优势、头部客户资源优势与产能规模优势，成功抓住了行业发展机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	7,457,614,029.81	6,794,333,019.93	9.76%	5,976,792,706.55
归属于上市公司股东的净资产	4,884,181,327.33	4,474,466,412.67	9.16%	4,181,051,624.18
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	3,793,892,570.42	3,149,984,434.89	20.44%	3,016,722,342.86
归属于上市公司股东的净利润	316,329,411.45	333,400,876.25	-5.12%	269,988,761.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,235,556.17	291,921,829.97	-20.10%	230,285,457.93
经营活动产生的现金流量净额	603,104,798.98	434,998,300.22	38.65%	439,725,336.22
基本每股收益（元/股）	0.3597	0.3837	-6.25%	0.3152
稀释每股收益（元/股）	0.3597	0.3837	-6.25%	0.3152

加权平均净资产收益率	6.76%	7.75%	-0.99%	6.60%
------------	-------	-------	--------	-------

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	780,702,419.71	1,015,031,744.71	1,106,838,005.55	891,320,400.45
归属于上市公司股东的净利润	62,347,621.76	86,942,736.51	95,777,320.62	71,261,732.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,350,070.75	53,607,375.50	85,455,032.51	52,823,077.41
经营活动产生的现金流量净额	149,998,573.12	-110,313,376.11	274,951,760.04	288,467,841.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.17%	116,898,280.00	0.00	不适用				0.00
深圳市特发集团有限公司	国有法人	8.11%	72,000,000.00	0.00	不适用				0.00
张美蓉	境内自然人	4.85%	43,029,702.00	32,983,426.00	不适用				0.00
深创投红土私募股权投资基金管理	其他	4.33%	38,434,415.00	0.00	不适用				0.00

(深圳)有限公司一深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	10,482,325.00	0.00	不适用	0.00
叶文新	境内自然人	0.81%	7,226,600.00	0.00	不适用	0.00
钟志海	境内自然人	0.80%	7,142,902.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司一南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	6,450,300.00	0.00	不适用	0.00
张国庭	境内自然人	0.50%	4,448,504.00	4,448,504.00	不适用	0.00
王秋勇	境内自然人	0.46%	4,079,343.00	3,995,243.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)与深圳市特发集团有限公司为一致行动人;公司未知其他股东间是否存在关联关系,也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

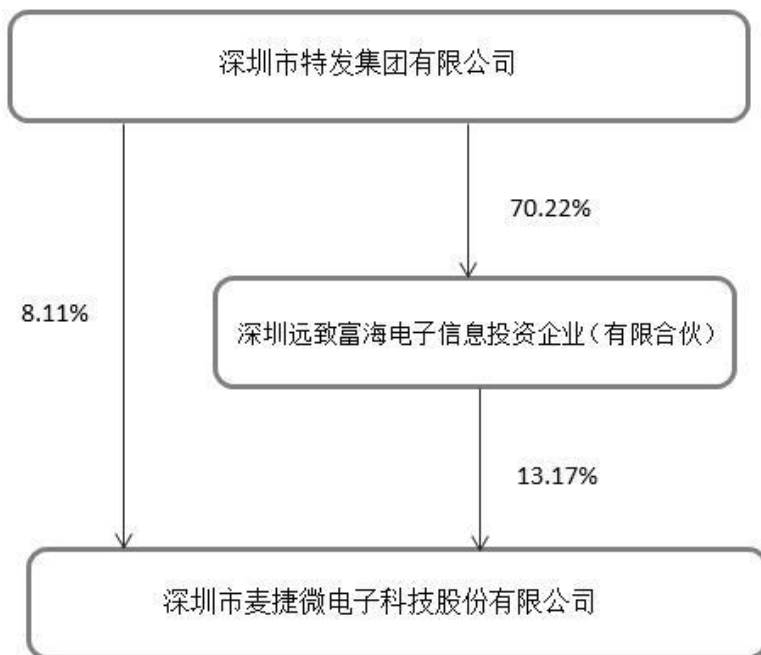
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。